

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ASMPT LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 0522)

截至二零二六年三月三十一日止三個月之 二零二六年第一季度未經審核業績公布

人工智能推動強勁需求

關鍵亮點

- * 多款產品受惠於人工智能技術的迭代
- * 集團季度新增訂單總額超出預期；表面貼裝技術解決方案分部新增訂單總額創新高
- * 受產品組合推動，半導體解決方案分部經調整毛利率達 46.4%
- * 銷售收入和經調整每股基本盈利皆勝市場預期

集團財務概要

(港幣百萬元)	二零二六年 第一季度	按季	按年
	持續經營業務		
新增訂單總額	5,673.4 (7.27 億美元)	+46.0%	+71.6%
銷售收入	3,966.8 (5.08 億美元)	+0.2%	+32.0%
毛利率	39.5%	+364 點子	-150 點子
經營利潤	385.2	+139.2%	+105.6%
盈利	323.8	-70.8%	+192.9%
每股基本盈利	港幣 0.78 元	-70.8%	+188.9%
	持續經營業務之非香港財務報告會計準則計量²		
經調整毛利率	39.5%	+357 點子	-151 點子
經調整經營利潤	395.7	+103.2%	+107.4%
經調整盈利	335.2	+123.8%	+193.5%
經調整每股基本盈利	港幣 0.81 元	+118.9%	+189.3%

(港幣百萬元)	二零二六年 第一季度	按季	按年
虧損	(72.6)	終止 ¹ 經營業務 -53.5%	+159.6%
經調整虧損(非香港財務報告會計準則計量 ²)	(72.6)	NM	+159.9%

NM: 無意義

(港幣百萬元)	二零二六年 第一季度	按季	按年
盈利	251.2	持續及終止 ¹ 經營業務 -73.7%	+204.1%
每股基本盈利	港幣 0.61 元	-73.5%	+205.0%
經調整盈利	262.6	持續及終止 ¹ 經營業務之非香港財務報告 會計準則計量 ² +24.1%	+204.4%
經調整每股基本盈利	港幣 0.64 元	+23.1%	+204.8%

二零二六年第二季度銷售收入預測

- * 將介乎 5.4 億美元至 6.0 億美元之間，以其中位數 5.7 億美元計按季上升 12.2%，按年亦上升 37.0%

- 1 正如集團於二零二五年第四季度所披露，集團已決定出售 ASMP T NEXX, Inc. (「NEXX」)，其被列作終止經營業務。截至本公告發布日，尚未就擬議之資產出售達成任何具約束力的協議。本集團將根據適用的披露責任之要求，在必要時提供進一步更新。
- 2 有關上述非香港財務報告會計準則計量之詳情，請參閱本業績公告之「香港財務報告會計準則計量與非香港財務報告會計準則計量之對賬」一節。

ASMP T Limited 董事會欣然宣布截至二零二六年三月三十一日止三個月之未經審核業績如下：

管理層討論及分析

除非另有說明，二零二六年第一季度回顧將僅涵蓋集團持續經營業務的業務及財務回顧，並根據非香港財務報告會計準則計量調整後呈列。

集團的兩大業務分部包括半導體解決方案分部（「SEMI」）及表面貼裝技術解決方案分部（「SMT」）。

二零二六年第一季度集團業務回顧 - 持續經營業務

人工智能推動對多項產品的需求

人工智能技術迅速發展正持續增加後端半導體製造的生產價值與複雜性。新的人工智能架構要求在數據中心、雲端及邊緣計算負載方面實現異質整合、更緊密的互連間距、更高的頻寬及能源效率。這些需求正推動封裝流程中更高的精確度、對正及工藝控制的要求，並進一步提升對集團解決方案的需求。當中包括用於先進邏輯與記憶體互連的熱壓焊接及混合式焊接，以實現成本效益規模化生產的高精確覆晶和回流焊接工藝，及隨著連接瓶頸顯現的光子及共同封裝光學。同時，人工智能基礎設施建設亦繼續支持半導體解決方案分部和表面貼裝技術解決方案分部主流應用，提供更高能源密度和可靠性。

管理層討論及分析（續）

熱壓焊接（「TCB」）

在邏輯方面，集團在第一季度實現大批量交付及接獲大批量重複訂單，從而鞏固了其在晶片到基底（「C2S」）的領導地位。在晶片到晶圓（「C2W」）方面，集團於第一季度接獲一名領先先進邏輯客戶訂購合共四台設備的訂單，用於其採用集團等離子主動去除氧化物（「AOR」）專利技術的超微間距 TCB 解決方案。集團亦積極地與多家主要邏輯企業就多項計劃合作，並已作好準備，把握行業發展更複雜邏輯晶片架構帶來的機會。

在記憶體方面，集團繼續走在技術發展的前沿，其中一家主要記憶體企業已採用其基於助焊劑的 TCB 工具並進行送樣驗證，同時認證集團針對 16 層 HBM4 技術的主動去除氧化物免助焊劑工藝。

光子及共同封裝光學（「CPO」）

集團光子解決方案的銷售收入按年增至五倍，主要由市場對 800G 及以上高速收發器的殷切需求所推動。其 1.6T 收發器解決方案獲得數據中心網絡供應鏈中主要光學供應商的大批量訂單。這彰顯集團光學收發器解決方案作為市場的領導者，深受市場青睞。

共同封裝光學標誌著人工智能系統設計的範式轉變。透過將光學引擎移至更緊鄰、甚至直接與運算晶片封裝並列配置，能顯著縮短電氣連線距離，進而降低能源消耗並提升系統效率。集團的共同封裝光學解決方案具高精確度焊接，將包括光纖列陣單元、微透鏡、電子集成電路及光子集成電路等多異質元件整合至單一高效光學引擎。集團繼續加強與多家全球領先的共同封裝光學企業的合作關係。隨着共同封裝光學的加速普及化，這將有利於集團進一步擴充市場份額。

覆晶高精度固晶（「FC」）

在第一季度，集團覆晶高精度固晶解決方案的新增訂單總額錄得強勁增長。

隨著大型人工智能封裝加速採用 2.5D 封裝技術，集團適用於晶圓級晶片封裝（「CoW」）與面板級晶片封裝（「CoP」）應用中的嵌入式橋接固晶鍵合的覆晶高精度固晶解決方案持續錄得穩定的訂單需求。集團的解決方案亦在用於無線射頻及能源設備的面板級扇出（「PLFO」）領域獲得市場青睞。這些解決方案提供成本效益、可擴展性和兼具卓越的配置準確度及產能。

混合式焊接（「HB」）

基於二零二五年的交付情況，集團的第二代混合式焊接解決方案繼續獲得進展，該方案在精確對正、焊接準確度、生產布局效率及每小時產能（「UPH」）方面皆具競爭力。集團近期亦啓用另一座 Class 100 無塵室，以進一步支持其與領先邏輯及記憶體企業在多個項目上的積極合作。

管理層討論及分析 (續)

半導體解決方案分部主流

半導體解決方案分部的主流業務受惠於全球領先整合設備製造商和外判半導體裝嵌及測試商的持續產能使用率，以及人工智能數據中心對能源管理解決方案的需求上升。在中國市場，主流業務對焊線機及固晶機應用需求增加，主要由人工智能基礎設施產能擴充及外判半導體裝嵌及測試商的強勁產能使用率所推動。

表面貼裝技術解決方案分部

於第一季度，表面貼裝技術解決方案分部的新增訂單總額創新高，主要受人工智能伺服器、光學收發器及中國電動汽車的強勁需求所推動。特別是在表面貼裝技術解決方案分部領域針對大型电路板的具高靈活性、高壓力解決方案已成為人工智能伺服器組裝的首選。該方案結合了大型及重型組件的快速取放、高密度與多角度貼片，以及更強的檢測能力，以提高良率與產能。

二零二六年第一季度集團財務回顧 - 持續經營業務

(港幣百萬元)	二零二六年第一季度	按季	按年
新增訂單總額	5,673.4 (7.27 億美元)	+46.0%	+71.6%
銷售收入	3,966.8 (5.08 億美元)	+0.2%	+32.0%
經調整毛利率	39.5%	+357 點子	-151 點子
經調整經營利潤	395.7	+103.2%	+107.4%
經調整盈利	335.2	+123.8%	193.5%
經調整每股基本盈利	港幣 0.81 元	+118.9%	+189.3%

二零二六年第一季度集團財務回顧

集團的銷售收入為港幣 39.7 億元 (5.08 億美元)，高於銷售收入預測的中位數，按季增長 0.2%，按年亦增長 32.0%。

集團的新增訂單總額為港幣 56.7 億元 (7.27 億美元)，遠超預期，按季增長 46.0%，按年亦增長 71.6%，創下四年來新高。增長來自對多項產品的需求，特別是表面貼裝技術解決方案分部產品、焊線機及固晶機及光子。集團錄得訂單對付運比率為 1.43。

集團經調整毛利率為 39.5%，按季上升 357 點子，按年則下降 151 點子。按季改善歸因於半導體解決方案分部的較高毛利率及銷售收入貢獻增加。按年下降則由於表面貼裝技術解決方案分部的銷售收入貢獻較高。

集團的經調整營運支出按季下降 4.6%，主要由於實施成本控制措施。經調整營運支出按年上升 12.4%，主要由於匯率的負面影響、策略性基礎設施及研發投資所致。

經調整盈利為港幣 3.35 億元，由經營利潤增加所推動按季增加 123.8%，按年亦增長 193.5%。

管理層討論及分析 (續)

二零二六年第一季度半導體解決方案分部財務回顧- 持續經營業務

(港幣百萬元)	二零二六年第一季度	按季	按年
新增訂單總額	2,414.2 (3.10 億美元)	+22.6%	+43.2%
銷售收入	2,143.7 (2.74 億美元)	+12.2%	+14.6%
經調整毛利率	46.4%	+594 點子	-37 點子
經調整分部盈利	309.4	+165.9%	+16.8%
經調整分部盈利率	14.4%	+834 點子	+27 點子

半導體解決方案分部於二零二六年第一季度的銷售收入增加至港幣 21.4 億元 (2.74 億美元)，按季增加 12.2%，按年亦增加 14.6%，佔集團總銷售收入約 54%。按季增長由高端固晶機及 TCB 所推動，而按年增長則來自主要由人工智能相關應用的多項產品所推動。

半導體解決方案分部的新增訂單總額為港幣 24.1 億元 (3.10 億美元)，按季增加 22.6%，按年亦增加 43.2%，主要由於中國外判半導體裝嵌及測試商、高端智能手機相關應用、人工智能相關能源管理應用及光學收發器推動對焊線機及固晶機的需求增長。半導體解決方案分部錄得訂單對付運比率為 1.13，已連續三個季度持續改善。

半導體解決方案分部於二零二六年第一季度的經調整毛利率為 46.4%，按季上升 594 點子，按年則輕微下降 37 點子。按季顯著改善主要由產品組合及銷量增加推動。

二零二六年第一季度的經調整分部盈利為港幣 3.09 億元，按季增加 165.9%，按年亦增加 16.8%。按季大幅增長是由於毛利率增加及經營槓桿效應。

二零二六年第一季度表面貼裝技術解決方案分部財務回顧

(港幣百萬元)	二零二六年第一季度	按季	按年
新增訂單總額	3,259.2 (4.17 億美元)	+70.0%	+101.1%
銷售收入	1,823.1 (2.33 億美元)	-11.0%	+60.7%
經調整毛利率	31.3%	-32 點子	-12 點子
經調整分部盈利	141.8	-28.3%	NM ¹
經調整分部盈利率	7.8%	-188 點子	+821 點子

NM¹: 無意義 - 二零二五年第一季度分部虧損

於二零二六年第一季度，表面貼裝技術解決方案分部錄得銷售收入港幣 18.2 億元 (2.33 億美元)，按季下降 11.0%，按年則增長 60.7%。按季下跌是由於季節性因素所致，而按年上升則受人工智能伺服器及中國電動車的強勁需求所推動。

管理層討論及分析（續）

表面貼裝技術解決方案分部的新增訂單總額創新高達港幣 32.6 億元（4.17 億美元），按季增加 70.0%，按年亦增加 101.1%，主要由人工智能伺服器、光學收發器及中國電動車的強勁需求所推動。

於二零二六年第一季度，表面貼裝技術解決方案分部的經調整毛利率為 31.3%，按季下降 32 點子，按年亦下降 12 點子。按季下跌是由於銷量減少，而按年下跌則是由於不利的終端市場組合影響，惟部分影響被銷量增加所抵銷。

二零二六年第一季度的經調整分部盈利為港幣 1.42 億元，按季減少 28.3%，主要因銷量下降所致，而按年有所改善。

前景

集團預期二零二六年第二季度的銷售收入將介乎於 5.4 億美元至 6.0 億美元之間，以其中位數 5.7 億美元計按季增長 12.2%，按年亦增長 37.0%，高於市場預期。此強勁增長將主要由半導體解決方案分部所推動。

集團預期二零二六年第二季度兩個業務分部的新增訂單總額將維持高位，而表面貼裝技術解決方案分部則或因高基數效應而按季下降。

人工智能的持續普及，預計將推動對 ASMP 多項產品的廣泛結構性需求。這涵蓋集團支援新一代人工智能運算與高頻寬記憶體的前沿 TCB 與混合式焊接解決方案、支援高速數據需求的光子及共同封裝光學，以及支援人工智能基礎設施部署的焊線及固晶和取放解決方案。展望未來，人工智能驅動的結構性需求預期將於二零二六年支持整體半導體解決方案分部及表面貼裝技術解決方案分部的銷售收入增長。

雖然中東地區持續的地緣政治局勢尚未對集團產生任何重大影響，但集團意識到不確定性依舊存在。集團憑藉其全球布局，將能靈活應對任何潛在影響，並繼續密切關注局勢發展並按需要靈活應變。

財務概要

簡明綜合損益表

		截至 二零二六年 三月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二五年 十二月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二五年 三月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核) (重列)
	<i>附註</i>			
持續經營業務				
銷售收入	2	3,966,800	3,958,972	3,004,968
銷貨成本		(2,400,752)	(2,539,995)	(1,773,529)
毛利		1,566,048	1,418,977	1,231,439
其他收入		37,169	74,871	40,129
出售合營公司所得收益		-	1,113,538	-
銷售及分銷費用		(397,931)	(417,313)	(337,623)
一般及行政費用		(291,587)	(337,798)	(254,844)
研究及發展支出		(491,353)	(502,825)	(451,646)
其他收益及虧損, 淨值及 聯營公司/ 合營公司業績持份		73,185	13,192	(26,577)
其他支出		(12,058)	(124,703)	(18,030)
財務費用		(38,420)	(42,237)	(49,459)
除稅前盈利		445,053	1,195,702	133,389
所得稅開支		(121,262)	(86,143)	(22,834)
持續經營業務的本期間盈利		323,791	1,109,559	110,555
終止經營業務				
終止經營業務的本期間虧損	3	(72,585)	(155,945)	(27,961)
本期間盈利		251,206	953,614	82,594
本公司持有人本期間應佔盈利(虧損):				
- 持續經營業務		326,405	1,113,004	111,599
- 終止經營業務		(72,585)	(155,945)	(27,961)
		253,820	957,059	83,638
非控股權益本期間應佔虧損:				
- 持續經營業務		(2,614)	(3,445)	(1,044)
本期間盈利		251,206	953,614	82,594

財務概要

簡明綜合損益表 (續)

		截至 二零二六年 三月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二五年 十二月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二五年 三月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核) (重列)
	附註			
每股盈利 (持續經營業務及終止 經營業務)	4			
- 基本		港幣 0.61 元	港幣 2.30 元	港幣 0.20 元
- 攤薄		港幣 0.61 元	港幣 2.29 元	港幣 0.20 元
每股盈利 (持續經營業務)	4			
- 基本		港幣 0.78 元	港幣 2.67 元	港幣 0.27 元
- 攤薄		港幣 0.78 元	港幣 2.66 元	港幣 0.27 元

簡明綜合損益及其他全面收益表

	截至 二零二六年 三月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二五年 十二月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二五年 三月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)
本期間盈利	251,206	953,614	82,594
其他全面收益(支出)			
<i>不會被重新分類至損益的項目:</i>			
- 界定福利退休計劃的除稅後重新計量	-	41,777	-
- 其他全面收益以公平價值列賬的權益 性工具投資之公平價值(減值)收益淨額	(139)	5	232
<i>其後可能會被重新分類至損益的項目:</i>			
- 換算海外營運公司匯兌差額	14,405	92,196	300,164
- 出售合營公司時將累計匯兌儲備 進行重新分類	-	35,310	-
- 被指定對沖現金流的對沖工具之 公平價值收益(減值)	4,847	(5,857)	(7,332)
本期間其他全面收益	19,113	163,431	293,064
本期間全面收益總額	270,319	1,117,045	375,658
以下各方本期間應佔全面收益(支出)總額:			
本公司持有人	270,559	1,119,348	376,352
非控股權益	(240)	(2,303)	(694)
	270,319	1,117,045	375,658
本公司持有人本期間應佔全面收益(支出)總額:			
- 持續經營業務	336,570	1,274,904	402,472
- 終止經營業務	(66,011)	(155,556)	(26,120)
	270,559	1,119,348	376,352

附註：

1. 主要會計政策

本財務概要是按歷史成本基準編製，惟於各報告期期末按公平價值計量之若干金融工具除外。歷史成本一般是根據商品及服務交換代價的公平價值。

2. 分部資料

本集團有兩個（二零二五年：兩個）經營分部：開發、生產及銷售（1）半導體解決方案及（2）表面貼裝技術解決方案。他們代表由集團製造的兩個（二零二五年：兩個）主要產品系列。

集團以可報告之經營分部分析銷售收入和業績如下：

	截至 二零二六年 三月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二五年 十二月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二五年 三月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核) (重列)
持續經營業務			
對外客戶分部銷售收入			
半導體解決方案	2,143,677	1,910,942	1,870,143
表面貼裝技術解決方案	1,823,123	2,048,030	1,134,825
	3,966,800	3,958,972	3,004,968
分部盈利（虧損）			
半導體解決方案	306,912	97,978	263,322
表面貼裝技術解決方案	141,063	193,060	(5,308)
	447,975	291,038	258,014
利息收入	27,284	18,893	24,444
財務費用	(38,420)	(42,237)	(49,459)
出售合營公司所得收益	—	1,113,538	—
未分配其他收入	6,174	4,506	5,403
未分配外幣淨匯兌收益(虧損)及 外幣遠期合約的公平價值變動	64,786	(13,793)	(33,513)
未分配一般及行政費用	(59,004)	(80,548)	(57,927)
未分配其他收益及虧損，淨值及 聯營公司/合營公司業績持份	8,316	29,008	44,456
未分配其他支出	(12,058)	(124,703)	(18,029)
除稅前盈利	445,053	1,195,702	133,389
分部盈利率			
半導體解決方案	14.3%	5.1%	14.1%
表面貼裝技術解決方案	7.7%	9.4%	-0.5%

3. 終止經營業務

為配合集團業務的策略發展，集團決定透過出售方式剝離半導體解決方案板塊內的 ASMP NEXX, Inc. (「NEXX」)業務。NEXX 是集團旗下獨立的半導體解決方案主要業務線，也是集團的現金產生單位。於二零二五年第四季度，由於 NEXX 業務預期將被出售而被歸類為持有待售資產，因此其構成終止經營業務。管理層已評估，並預期將於二零二六年完成 NEXX 業務的出售。

NEXX 業務的業績已於簡明綜合損益表以呈現其為終止經營業務，具體如下：

	截至 二零二六年 三月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二五年 十二月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二五年 三月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核) (重列)
銷售收入	107,262	374,540	119,625
銷貨成本	(79,128)	(209,937)	(72,949)
毛利	28,134	164,603	46,676
其他收入	985	1,643	1,266
銷售及分銷費用	(23,673)	(34,996)	(27,385)
一般及行政費用	(9,360)	(14,526)	(6,935)
研究及發展支出	(38,414)	(41,374)	(39,750)
財務費用	(392)	(442)	(528)
確認商譽減值損失	–	(217,386)	–
除稅前虧損	(42,720)	(142,478)	(26,656)
所得稅開支	(29,865)	(13,467)	(1,305)
本期間虧損	(72,585)	(155,945)	(27,961)

4. 每股盈利

本公司持有人應佔每股基本及攤薄盈利是根據下列數據計算：

	截至 二零二六年 三月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二五年 十二月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二五年 三月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核) (重列)
本公司持有人應佔之本期間盈利 (來自持續及終止經營業務)	253,820	957,059	83,638
減：本期間來自終止經營業務的虧損	(72,585)	(155,945)	(27,961)
計算每股基本及攤薄盈利之盈利 (本公司持有人應佔之本期間盈利)	326,405	1,113,004	111,599
	截至 二零二六年 三月三十一日 止三個月 (未經審核)	截至 二零二五年 十二月三十一日 止三個月 股份之數量 (以千位計) (未經審核)	截至 二零二五年 三月三十一日 止三個月 (未經審核)
計算每股基本盈利之普通 股加權平均股數	417,674	416,443	416,443
潛在攤薄影響之股數： - 僱員股份獎勵計劃	613	1,402	8
計算每股攤薄盈利之普通股 加權平均股數	418,287	417,845	416,451

終止經營業務

截至二零二六年三月三十一日止三個月，來自終止經營業務本期間虧損港幣 72,585,000 元（二零二五年第四季度：虧損港幣 155,945,000 元，二零二五年第一季度：虧損港幣 27,961,000 元），以上文詳述的基本每股盈利的分母計算，終止經營業務的基本及攤薄每股虧損為港幣 0.17 元（二零二五年第四季度：港幣 0.37 元，二零二五年第一季度：港幣 0.07 元）。在計算本附注中所提及的相關期間之終止經營業務的攤薄後每股虧損時，僱員股份獎勵計劃中潛在股份的計入會導致來自終止經營業務的攤薄後每股虧損減少而因此不被包括在計算中。

香港財務報告會計準則計量與非香港財務報告會計準則計量之對賬

就財務表現回顧，集團已提供經調整盈利及經調整每股盈利，作為集團根據香港財務報告會計準則呈列的綜合業績之補充。集團相信，上述額外數據能為股東及投資者提供有關集團持續經營表現的有用補充資料，有助分析及比較各期間的財務趨勢及業績。經調整盈利及經調整每股盈利不包括 (i) 以股份為基礎的支出、(ii) 主要與僱員遣散費用及福利安排和停工相關成本的重組成本、(iii) 出售合營公司所得收益、(iv) 投資聯營公司攤薄之虧損、(v) 確認商譽及無形資產減值損失及 (vi) 相關所得稅之影響。

根據集團僱員股份獎勵計劃以股份為基礎的支出已計入香港財務報告會計準則報告中。至於非香港財務報告會計準則之計量，為使各期間的經營業績更具可比性，該項支出已予以排除。管理層認為，股份為基礎的支出之金額可能因授予時間、歸屬期或市場價格波動而有所不同，剔除將有助於提高各期間經營業績的可比性。

採用這些非香港財務報告會計準則計量作為分析及比較工具或存在一定的局限性。故建議股東及投資者不應將其與集團根據香港財務報告會計準則所呈報的財務業績分開考慮或視作替代分析。此外，這些非香港財務報告會計準則計量的定義可能有別於其他公司使用的類似詞彙。

下表載列集團根據香港財務報告會計準則編製的二零二六年第一季度、二零二五年第四季度及二零二五年第一季度財務計量與非香港財務報告會計準則計量的對賬。

	三個月止		
	二零二六年 第一季度 港幣千元 (未經審核)	二零二五年 第四季度 港幣千元 (未經審核) (重列)	二零二五年 第一季度 港幣千元 (未經審核) (重列)
<u>持續經營業務</u>			
毛利	1,566,048	1,418,977	1,231,439
非香港財務報告會計準則調整:			
–以股份為基礎的支出	–	2,698	242
經調整毛利	1,566,048	1,421,675	1,231,681
毛利率	39.5%	35.8%	41.0%
經調整毛利率	39.5%	35.9%	41.0%
經營利潤	385,177	161,041	187,326
非香港財務報告會計準則調整:			
–以股份為基礎的支出	10,491	33,701	3,405
經調整經營利潤	395,668	194,742	190,731

香港財務報告會計準則計量與非香港財務報告會計準則計量之對賬 (續)

	三個月止		
	二零二六年 第一季度 港幣千元 (未經審核)	二零二五年 第四季度 港幣千元 (未經審核) (重列)	二零二五年 第一季度 港幣千元 (未經審核) (重列)
<u>持續經營業務</u>			
盈利	323,791	1,109,559	110,555
非香港財務報告會計準則調整:			
- 以股份為基礎的支出	10,491	33,701	3,405
- 重組成本	3,635	37,501	879
- 出售合營公司所得收益	-	(1,113,538)	-
- 投資聯營公司攤薄之虧損	-	5,034	-
- 商譽及無形資產減值損失	-	66,972	-
- 相關所得稅之影響	(2,697)	10,542	(616)
經調整持續經營業務之盈利	335,220	149,771	114,223
<u>終止經營業務</u>			
虧損	(72,585)	(155,945)	(27,961)
非香港財務報告會計準則調整:			
- 以股份為基礎的支出	-	461	37
- 商譽及無形資產減值損失	-	217,386	-
- 相關所得稅之影響	-	(113)	(9)
經調整自終止經營業務之(虧損)盈利	(72,585)	61,789	(27,933)
經調整自持續及終止經營業務之盈利	262,635	211,560	86,290
經調整盈利率(自持續經營業務)	8.5%	3.8%	3.8%
經調整盈利率(自持續及終止經營業務)	6.4%	4.9%	2.8%
經調整每股基本盈利(自持續經營業務)	港幣 0.81 元	港幣 0.37 元	港幣 0.28 元
經調整每股基本盈利(自持續及終止經營業務)	港幣 0.64 元	港幣 0.52 元	港幣 0.21 元

香港財務報告會計準則計量與非香港財務報告會計準則計量之對賬 (續)

下表載列半導體解決方案分部（「SEMI」）和表面貼裝技術解決方案分部（「SMT」）根據香港財務報告會計準則編製的二零二六年第一季度、二零二五年第四季度及二零二五年第一季度財務計量與非香港財務報告會計準則計量的對賬。

	三個月止					
	二零二六年第一季度		二零二五年第四季度		二零二五年第一季度	
	半導體 解決方案 分部	表面貼裝 技術解決 方案分部	半導體 解決方案 分部	表面貼裝 技術解決 方案分部	半導體 解決方案 分部	表面貼裝 技術解決 方案分部
港幣千元 (未經審核)		港幣千元 (未經審核)		港幣千元 (未經審核)		
		(重列)		(重列)		
持續經營業務						
毛利	994,790	571,258	770,787	648,190	874,485	356,954
非香港財務報告會計 準則調整:						
- 以股份為基礎的支出	-	-	2,526	172	224	18
經調整毛利	994,790	571,258	773,313	648,362	874,709	356,972
毛利率	46.4%	31.3%	40.3%	31.6%	46.8%	31.5%
經調整毛利率	46.4%	31.3%	40.5%	31.7%	46.8%	31.5%
分部盈利 (虧損)	306,912	141,063	97,978	193,060	263,322	(5,308)
非香港財務報告會計 準則調整:						
- 以股份為基礎的支出	2,492	783	18,401	4,733	1,557	417
經調整分部盈利 (虧損)	309,404	141,846	116,379	197,793	264,879	(4,891)
分部盈利率	14.3%	7.7%	5.1%	9.4%	14.1%	-0.5%
經調整分部盈利率	14.4%	7.8%	6.1%	9.7%	14.2%	-0.4%

財務報表審閱

審核委員會已審閱集團截至二零二六年三月三十一日止三個月期間未經審核的簡明綜合財務報表。

董事會

於本公告日期，本公司董事會成員包括獨立非執行董事：樂錦壯先生（主席）、張仰學先生、蕭潔雲女士及許明明女士；非執行董事：Hichem M'Saad博士及 Paulus Antonius Henricus Verhagen先生；執行董事：黃梓達先生及Guenter Walter Lauber先生。

承董事會命
董事
黃梓達

香港，二零二六年四月二十一日

(本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。)